

# 精密電子部品加工機における位置決め技術

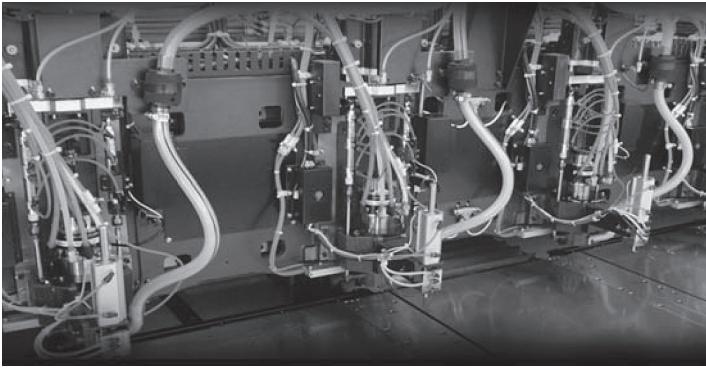


図1 プリント基板ドリル穴開け加工機の位置決め機構の



図2 電子部品実装ロボットの部品吸着ヘッド位置決め機構

サーの実装には、数十ミクロンの位置決め加工精度が必要である。一方、5Gネットワークなど大型化する通信インフラ機器や輸送機器など、高性能・高信頼性が要求される電子回路では、中央演算処理装置（CPU）の

富な電子回路を構成するプリント基板の製造には、要求仕様を満足可能な高速・高精度な電子部品加工機が必要とされ、その実現には高精度な機械設計のみならず、機械構造体、アクリュエーター、センサー、制御の四つの機

構振動、摩擦やヒステリシスなどの非線形要素、未知の外力や経年・温度変化による機構特性変動が挙げられる。制御工学では、これらの要因を「等価的な外乱集合」として扱い、ロバスト制御性能（外乱に対する頑強性）

て高い効果を発揮する  
「反復学習制御」、機  
械学習や最適化アルゴ  
リズムを併用した「精  
密モデリング（高精度  
シミュレーター）」な  
どの制御アプローチ  
が、さまざま位置決  
め制御システムに実装  
されている。これらの

品そのもののノード数や  
狭隣接美装が求められ  
る。例えば「ウエハーレ  
ベルチップサイズパッ  
ケージ」と呼ばれる超  
小型半導体積回路な  
どの最先端部品や、0  
201サイズ(幅0・  
25ミリ×奥行き0・12  
5ミリ×高さ0・125  
ミリ)のチップ抵抗器  
やクラミンフコネク  
タ等。

高出力二酸化炭素(CO<sub>2</sub>)レーザーをドリルで加工するプロセスが主流であり、最新のレーザー加工機では、数百ミクロン径のビア・ホールを、1秒間に数万穴の速度、10倍程度の精度で穴開け加工する。以上のように

て携わってきた。図1、2は、プリント基板ドリル穴開け機と電子部品実装ロボットの位置決め機構の例を示したものである。

さらに、近年の制御技術のトレンドとして、非線形要素に対して制御性能向上が期待できる「モデル予測制御」や、繰り返し作業を担保する。

## 精密電子部品加工 機に求められる課題

性能向上に伴うバッケージ部品やソケットサイズが大型化・重量化

能を統合したシステムとして、制御技術との合わせ技が必須となる。

# 名古屋工業大学大学院 工学研究科 電気・機械工学専攻

# 教 授 岩崎 誠